



達興材料股份有限公司

股票代碼：5234

法人說明會

2025.02.26



免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。



簡報大綱

◆ 公司簡介

◆ 經營成果

◆ 未來展望

公司簡介



公司基本資料

創立日期

2006年7月12日
(友達光電及長興材料合資成立)

資本額

新臺幣10.27億

員工人數

截至2025年1月之員工人數為 424 人
研發人員 > 50%

上市日期

2012年7月16日 (股票代號：5234)

合併營收

2024年：41.18億

主要營業項目

半導體材料
顯示器材料
關鍵原材料
其他特用精細化學材料

主要產品

半導體材料

- 用途: 應用於晶圓製程及封裝製程之直接永久材料及間接製程材料
- 產品: 有機離型層、剝離液、高純度溶劑、蝕刻液、特用保護膠材等

顯示器材料

- 用途: 應用於LCD Array, Cell, Color Filter之直接永久材料及間接製程材料
- 產品: 光阻、配向膜、蝕刻液、光學膠、保護層、濕式化學品等

關鍵原材料

- 用途: 應用於綠能產業及化學相關應用之上游關鍵原料
- 產品: 特用單體、壓克力高分子、鋰電池矽負極高分子等

經營成果



合併綜合損益表-1

Unit : NTD M

	2024 Q4		2024 Q3		QoQ	2023 Q4		YoY
營業收入	1,067.4	100.0%	1,073.5	100.0%	(0.6%)	997.6	100.0%	7.0%
營業成本	664.6	62.3%	675.5	62.9%	(1.6%)	646.9	64.8%	2.7%
營業毛利	402.9	37.7%	398.0	37.1%	1.2%	350.7	35.2%	14.9%
銷售費用	49.5	4.6%	51.4	4.8%	(3.6%)	45.1	4.5%	9.8%
管理費用	55.8	5.2%	53.2	5.0%	5.0%	51.6	5.2%	8.2%
研發費用	130.6	12.2%	123.6	11.5%	5.6%	119.6	12.0%	9.1%
預期信用減損損失	-	0.0%	-	0.0%	0.0%	(3.0)	(0.3%)	(100.0%)
營業費用	235.9	22.1%	228.2	21.3%	3.4%	213.3	21.4%	10.6%
營業淨利	166.9	15.6%	169.8	15.8%	(1.7%)	137.4	13.8%	21.5%
營業外收(支)	38.7	3.6%	(14.1)	(1.3%)	(374.5%)	(14.7)	(1.5%)	(363.5%)
稅前淨利	205.6	19.3%	155.7	14.5%	32.0%	122.7	12.3%	67.5%
所得稅費用	25.9	2.4%	22.6	2.1%	14.7%	13.9	1.4%	86.1%
本期淨利	179.7	16.8%	133.1	12.4%	35.0%	108.8	10.9%	65.1%
其他綜合損益	-	0.0%	-	0.0%	0.0%	1.3	0.1%	(100.0%)
綜合損益總額	179.7	16.8%	133.1	12.4%	35.0%	110.1	11.0%	63.2%
基本每股盈餘 (NTD)	1.75		1.30			1.06		

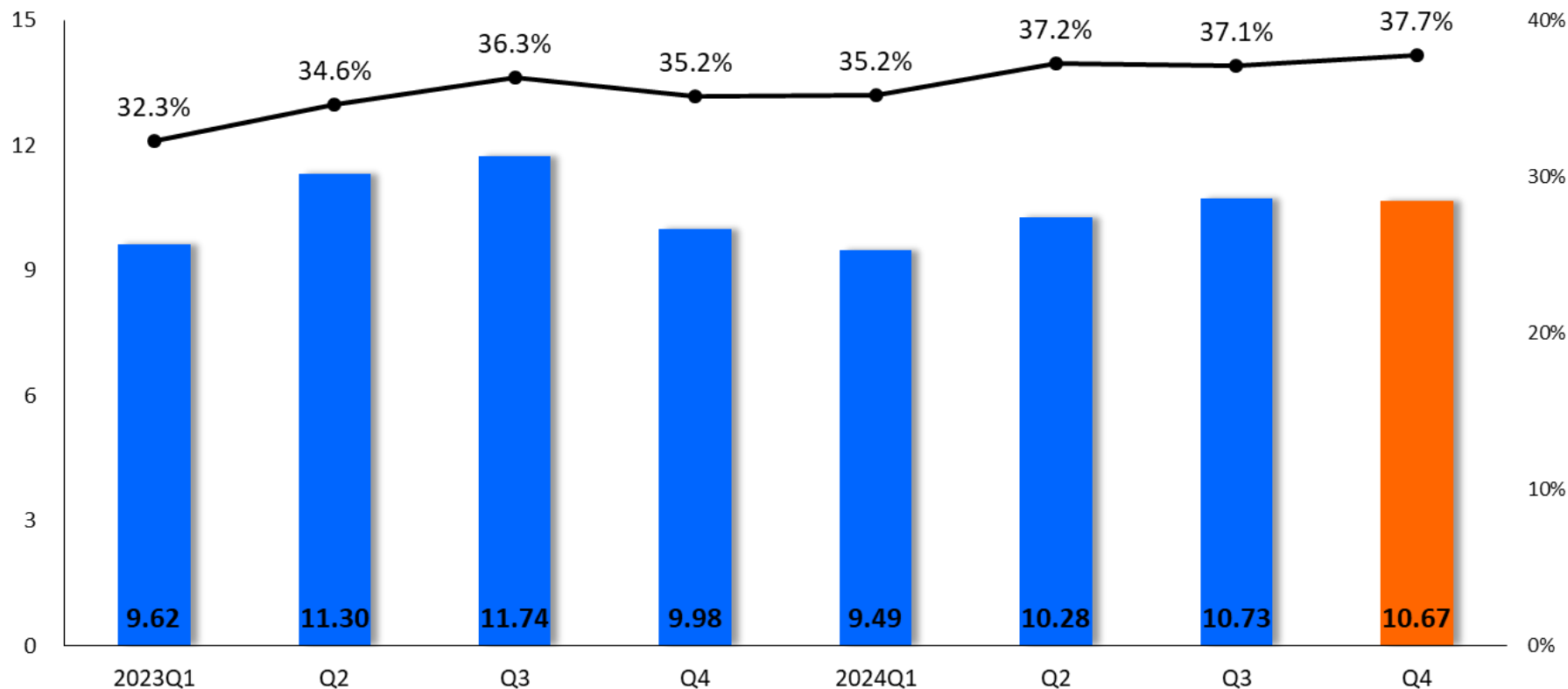
合併綜合損益表-2

Unit : NTD M	2024年		2023年		年成長
營業收入	4,117.8	100.0%	4,264.1	100.0%	(3.4%)
營業成本	2,600.0	63.1%	2,785.0	65.3%	(6.6%)
營業毛利	1,517.8	36.9%	1,479.1	34.7%	2.6%
銷售費用	196.2	4.8%	185.8	4.4%	5.6%
管理費用	216.5	5.3%	204.7	4.8%	5.7%
研發費用	498.0	12.1%	480.8	11.3%	3.6%
預期信用減損損失	-	0.0%	(3.0)	(0.1%)	(100.0%)
營業費用	910.7	22.1%	868.3	20.4%	4.9%
營業淨利	607.2	14.7%	610.8	14.3%	(0.6%)
營業外收(支)	51.4	1.2%	(5.3)	(0.1%)	(1063.1%)
稅前淨利	658.6	16.0%	605.4	14.2%	8.8%
所得稅費用	88.0	2.1%	82.1	1.9%	7.2%
本期淨利	570.6	13.9%	523.4	12.3%	9.0%
其他綜合損益	-	0.0%	1.3	0.0%	(100.0%)
綜合損益總額	570.6	13.9%	524.7	12.3%	8.8%
基本每股盈餘 (NTD)	5.56		5.10		



營收及毛利率趨勢

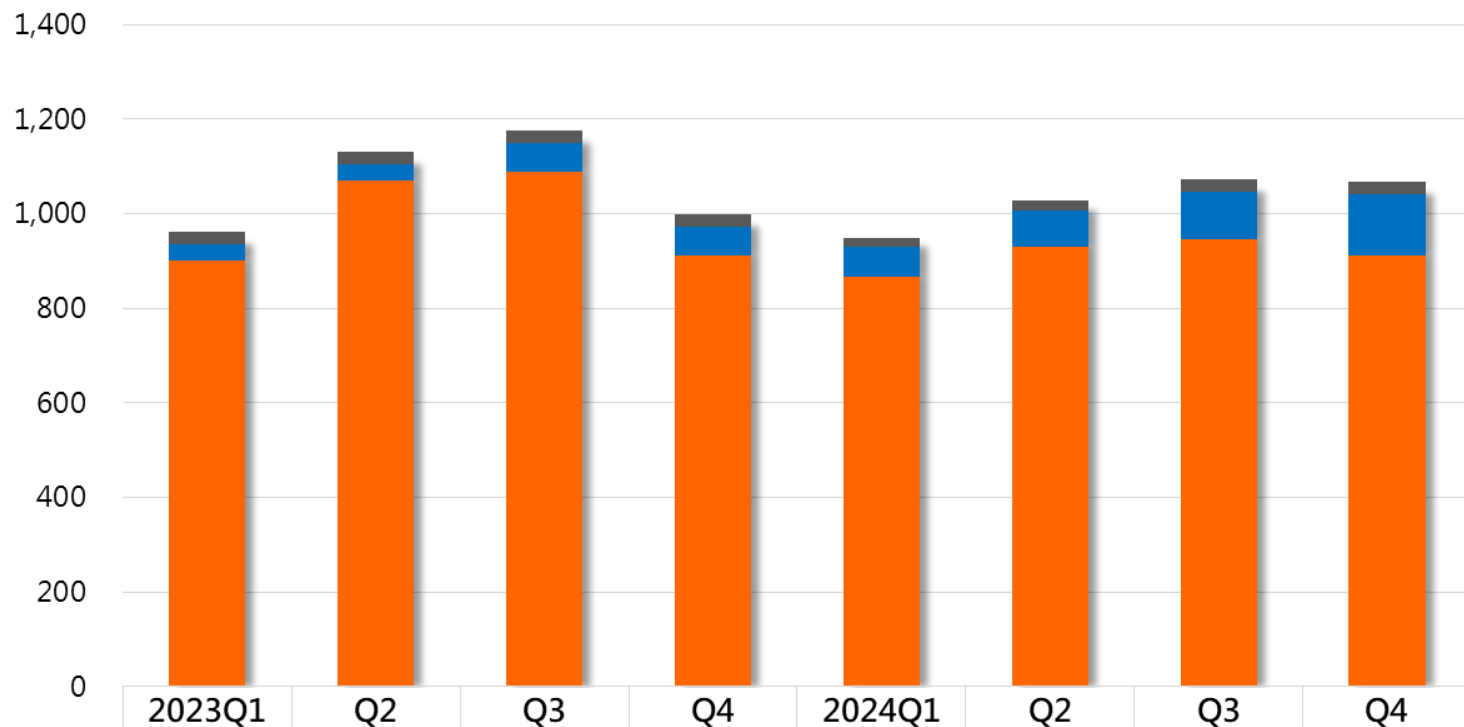
NTD 億



產業別營收

(NTD M)

DAXiN

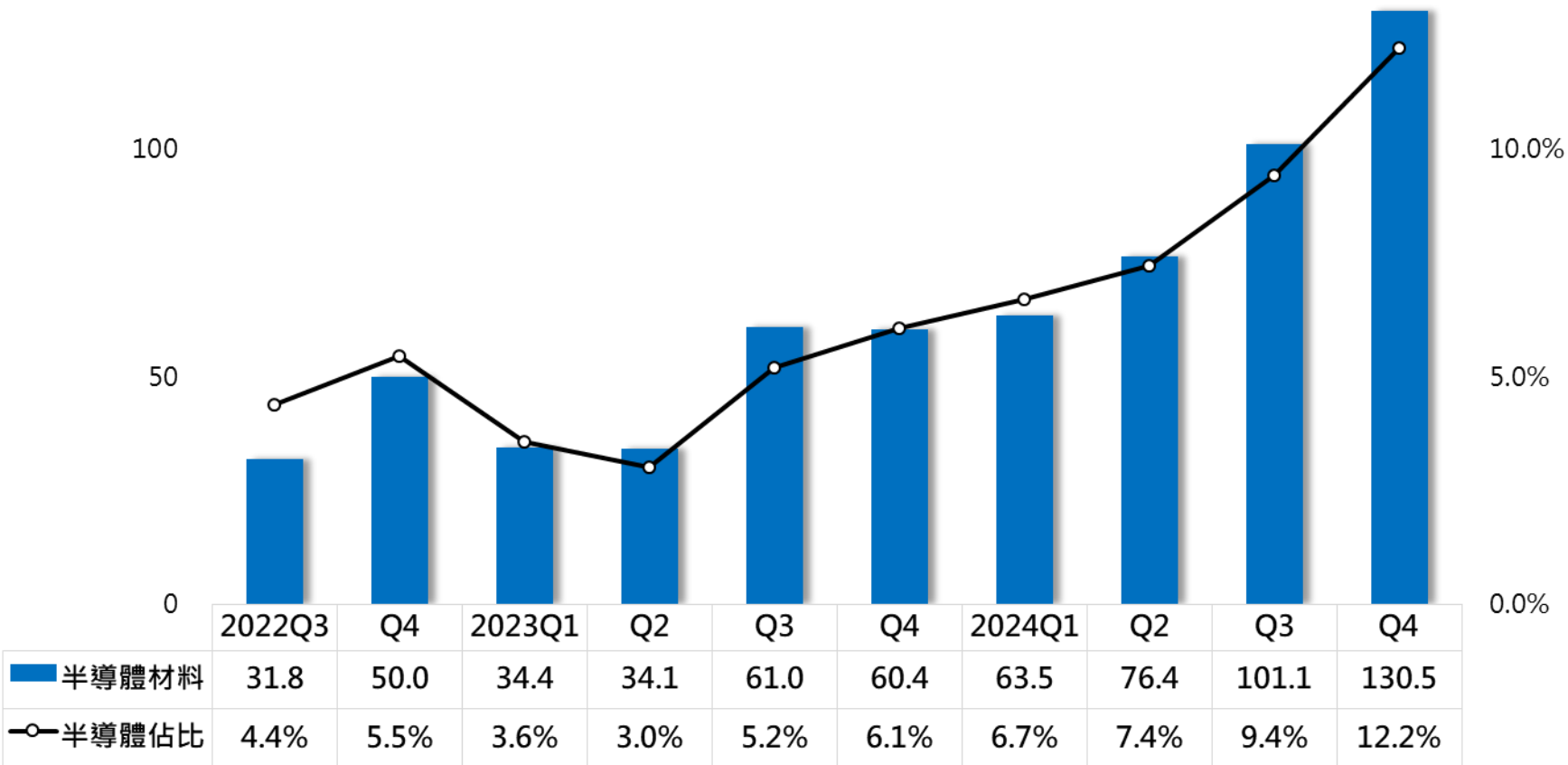


	2023Q1	Q2	Q3	Q4	2024Q1	Q2	Q3	Q4
■ 關鍵原材料及其他	27.8	26.6	25.2	26.8	19.3	22.6	27.6	25.7
■ 半導體材料	34.4	34.1	61.0	60.4	63.5	76.4	101.1	130.5
■ 顯示器材料	899.7	1,069.6	1,088.1	910.4	866.0	929.2	944.7	911.2
TOTAL	961.9	1,130.3	1,174.3	997.6	948.8	1,028.2	1,073.5	1,067.4
關鍵原材料及其他佔比	2.9%	2.4%	2.1%	2.7%	2.0%	2.2%	2.6%	2.4%
半導體佔比	3.6%	3.0%	5.2%	6.1%	6.7%	7.4%	9.4%	12.2%

半導體營收

(NTD M) 150

15.0%



合併資產負債表摘要



Unit: NTD M

	2024/12/31		2023/12/31		年成長	年成長 %
現金及約當現金	195	3.9%	244	5.7%	(49)	(20.1%)
按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動	1,424	28.8%	1,161	19.0%	263	22.7%
應收帳款	1,133	22.9%	1,069	26.3%	64	6.0%
存貨	380	7.7%	338	8.2%	41	12.2%
不動產、廠房及設備	1,480	29.9%	1,545	33.6%	(65)	(4.2%)
使用權資產	155	3.1%	164	3.6%	(9)	(5.5%)
資產總計	4,949	100.0%	4,642	100.0%	307	6.6%
流動負債	1,266	25.6%	1,088	25.7%	178	16.4%
非流動負債	399	8.1%	420	9.5%	(20)	(4.9%)
負債總計	1,665	33.6%	1,507	35.3%	158	10.5%
權益總計	3,284	66.4%	3,135	64.7%	150	4.8%

重要財務指標

流動比率%	257%	267%
存貨週轉天數	50	46



合併現金流量表摘要

Unit: NTD M

	2024年	2023年
本期稅前淨利	659	605
折舊及攤銷	271	260
營運資金變動	27	(70)
營業活動之淨現金流入	865	725
取得不動產、廠房及設備	(190)	(218)
按攤銷後成本衡量之金融資產增加	(280)	(107)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(46)	-
投資活動之淨現金流出	(518)	(329)
銀行借款淨變動	34	7
發放現金股利	(421)	(339)
籌資活動之淨現金流出	(396)	(365)
本期現金及約當現金增(減少)增加	(49)	33

註：2024/12/31及2023/12/31期末現金及約當現金加計超過三個月以上定存餘額分別為1,617M及1,404M。



股利政策

■ 維持高配息政策。

年度	EPS	現金股利	股票股利	股利發放比率
2024	5.56	5.0	0.0	90%
2023	5.10	4.1	0.0	80%
2022	4.15	3.3	0.0	80%
2021	6.62	5.3	0.0	80%
2020	6.15	5.0	0.0	81%

未來展望



產品佈局



半導體營運成果與計畫

量產中

測試驗證中

DAXin

營運三大主軸

先進封裝

Advanced
Packaging
Integration

成熟製程

BEOL
Interconnections

先進製程

FEOL
Transistor

Source: 2023 Applied Materials, Yole

自主開發

雷射離型層

高選擇比蝕刻液
轉貼製程離型層
感光介電絕緣層
高信賴性接著膠

底部抗反射塗層剝離液

光阻頂部塗層
光阻頂部抗反射塗層
光阻潤濕液

高純度溶劑

高選擇比蝕刻液
乾蝕刻後清洗液

與半導體大廠 合作開發

晶邊保護膠

光阻周邊材料

乾蝕刻後清洗液A
乾蝕刻後清洗液B
介電層表面處理液
金屬表面保護層
特用蝕刻液
綠色產品潤濕液

與半導體化學品 大廠合作開發

光阻剝離液A

光阻剝離液B

高純度高分子A
高純度高分子B

光阻剝離液

- ◆ 半導體相關產品共25項：其中，9項產品導入量產，16項產品測試驗證中，2025年有望新增驗證導入3~5項產品，另有多項產品評估開發中。
- ◆ 與半導體化學品大廠合作開發：
2024年4間大廠合作共4項產品，2025年有望新增新客戶新產品。

顯示器營運成果與計畫

1 LCD 新規格新產品開發

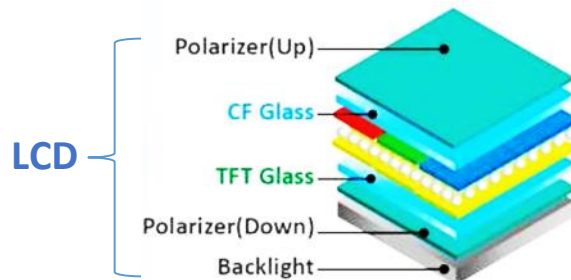
低溫製程材料(ESG)、
Cu stripper、FFS液
晶配向膜PI、膽固醇
液晶配向膜

2 銷售重點 - 液晶配向膜PI

擴大液晶配向膜 PSA PI
導入新客戶新量產廠區

3 強化成本競爭力、提升市場佔有率

優化生產製程、
提高原料自製比例
保持PS, Cu蝕刻液優勢、
擴大配向膜PI市佔



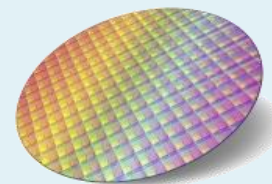
*FFS : Fringe-field switching
*PSA : Polymer Stabilized Alignment

2025年營運展望

基於當前業務展望，達興材料預期2025年將持續投資並穩健成長：

◆ 半導體材料方面

- 三種經營模式並進，半導體營收表現有望大幅成長
(1. 自主研發；2. 與半導體化學品大廠合作開發；3. 與半導體大廠合作開發)
- 擴大與半導體化學品大廠合作項目及模式
- 增建產線擴充產能以滿足先進製程/先進封裝需求
- 開發AI相關應用產品相關特用化學材料



◆ 顯示器材料方面

- 重點產品 - 液晶配向膜PI 於新客戶新廠區加速放量
- 提升品質及價格競爭力，保持優勢及擴大市佔
- 開發更高規格及符合ESG低溫新材料



Q & A



Thank you

